

2026年8月25日

### エレクトロニクス開発・実装展「第5回ネプコンジャパン」に出展します

東洋紡エムシー株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長執行役員 CEO:藤井 尚毅、以下「当社」)は、2026年9月9日～11日まで、幕張メッセで開催される「第5回ネプコンジャパン[秋]」に出展します。本展示会は、エレクトロニクス機器の多機能化・高性能化を支える最先端の電子部品・材料や製造・実装・検査装置が集結する展示会です。

当社の出展ブースでは、開発品であるノンハロゲン系難燃タイプの低圧成形封止材「バイロショット®」を初出展します。

「バイロショット®」はプリント基板や電子部品の保護が可能な低圧成形封止材で、流動性が高く、低い圧力で成形できるため電子部品への負荷を抑制できるのが特長です。電子部品を保護する封止材には難燃性が求められますが、一般的に使用されるハロゲン系難燃剤は、燃焼時に有毒ガスが発生する問題が指摘されていました。欧州を中心に「ノンハロゲン系難燃剤」の需要が高まっており、開発品はこうしたニーズを受けて開発したものです。加えて、封止材に必要な高耐久性・高接着性も併せ持ちます。

本展示会を通じて、注力領域である電材分野での認知向上と販売拡大を図ります。皆様のご来場をお待ちしております。



当社の出展ブースイメージ

#### 1. 出展する製品

- 低圧成形封止材「バイロショット®」
- ノンハロゲン系難燃タイプ「バイロショット®」(開発品)

#### 2. 「第5回ネプコンジャパン[秋]」について

- 会期 : 2026年9月9日(水)～11日(金) 10:00～17:00
- 会場 : 幕張メッセ ホール1～3
- ブース番号 : A9-30
- URL : [ネプコンジャパン\[秋\]](#)

以上

このニュースリリースに掲載されている内容は、発表日時点の情報です。発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

#### ■お問い合わせ先

東洋紡エムシー株式会社 経営企画部 企画・広報グループ Mail : [info\\_tmc@toyobo-mc.jp](mailto:info_tmc@toyobo-mc.jp) Tel : 06-6348-3310